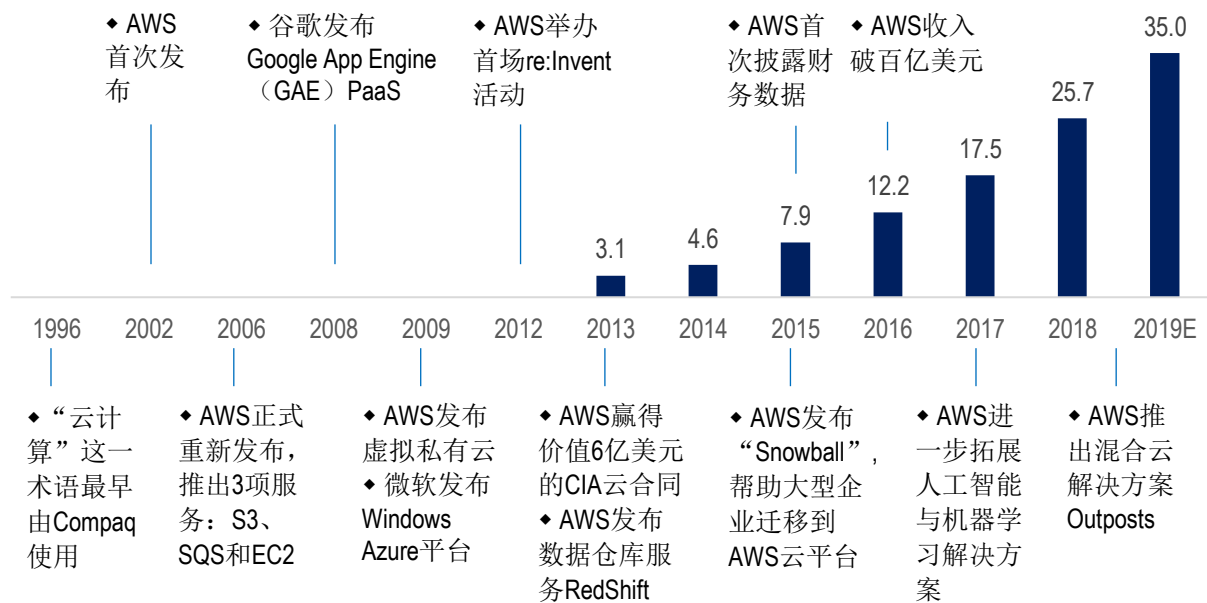




AWS – re:Invent 2019 重点总结

图 1: AWS 大事记及 AWS 收入趋势 (十亿美元)



来源: computerworld.com, 尚乘研究预测

尚乘观点: 为了继续在新产品和客户解决方案上与主要对手竞争，AWS在本月初的 re:Invent 2019 上推出了一系列新产品和服务。此次发布的重点包括用于云计算的新芯片，对数据仓库 RedShift 的改进，机器学习服务 SageMaker 的新功能，以及最重要的一一私有云和边缘计算解决方案。就广度和深度而言，我们认为 AWS 仍是云计算行业的领导者。关于收入，我们预计 AWS 的总收入将在 2019 年同比增长 36% 至 350 亿美元（具体内容请参阅英文版本）。

尚乘研究
 李小明
 +852 3163-3384
 brian.li@amtdgroup.com

尚乘研究
 李蕾
 +852 3163-3383
 michelle.li@amtdgroup.com

尚乘研究
 吴若滢
 +852 3163-3242
 roy.wu@amtdgroup.com

新闻更新

2019年12月10日

智能手机

小米

小米正式发布红米 K30 5G，目前市场上最实惠的 5G 手机

Redmi K30 正式在中国推出，手机提供 4G 和 5G 两种版本。Redmi K30 5G 全球首发高通首款集成式 5G 处理器骁龙 765G 移动平台，采用顶级的 7nmEUV 制程工艺。得益于集成骁龙 X52 调制解器，手机可支持双模 5G（SA 和 NSA），同时手机还具有 MultiLink 三路并发功能。Redmi K30 5G 使用 6.67 英寸 LCD 显示屏，刷新率为 120Hz。显示屏采用了挖孔屏，右上角双挖孔，搭载一颗 2000 万像素自拍摄像头和一颗 200 万像素景深摄像头。Redmi K30 5G 背部搭载有一颗 6400 万像素主摄像头（配有索尼 IMX686 感光元件），一颗 800 万像素超广角摄像头（120 度超广角），一颗 500 万微距摄像头和一颗 200 万像素的景深摄像头。Redmi K30 5G 配有 12 组天线设计，并支持双频 GPS。6GB / 64GB 机型售价为人民币 1,999 元（284 美元），其实惠的价格使其成为最便宜的 5G 手机。（来源：[GizmoChina](#)）

2019年12月9日

可穿戴设备

Realme

Realme 将推出其首款无线耳机 Realme Buds Air

Realme 将于 12 月 17 日推出其首款无线耳机 Realme Buds Air。这款耳机的外观与 AirPods 相似，有白、黄、黑三种配色选择。在配置上，将采用 12 纳米低音驱动器、蓝牙 5.0 连接，支持开盖即连，可以通过智能触控来控制音乐播放、通话等，并内置 Google Assistant 语音助手。Realme 为老顾客和参与推广活动的用户提供了 400 卢比的优惠券。（来源：[Gadget](#)）

2019年12月9日

智能手机

Oppo

Oppo Reno 3 Pro 预计将要发布，已确认将搭载双模 5G 芯片

Oppo 宣布 Oppo Reno 3 Pro 将搭载 Snapdragon 765G SoC，支持双模 5G。一些媒体声称该手机将配备四后置摄像头，将包括一个 4,800 万像素的主摄像头，一个 1,300 万像素的第二摄像头，800 万像素的第三摄像头和一个 200 万像素的景深摄像头。同时，该手机据说还支持 30W 的快速充电。到目前为止，尚不清楚 Oppo Reno 3 Pro 的具体上市时间和发售价格。（来源：[GizmoChina](#)）

2019年12月6日

半导体

台积电

台积电 5 纳米制程将于 2Q20 开始量产

台积电将于 2Q20 开始量产 5 纳米制程，产能可能比最初预计的翻倍。该公司同时规划在 2022 年量产 3 纳米工艺；2020 年的资本支出将与今年相近，在 140 亿到 150 亿美元左右。新竹的新研发中心将于 1Q20 动工，预计 2021 年完工启用，会成为台积电未来 20 年先进技术的研发基地。（来源：[Gizchina](#)）

2019年12月6日

华为将发布麒麟 1020 和麒麟 820 芯片

半导体

华为

华为可能于 2020 年 9 月发布高端麒麟 1020 芯片和中端麒麟 820 芯片。据报道，麒麟 1020 芯片将采用 5 纳米工艺制程制造，基于 ARM A77 CPU 架构，内置 5G 调制解调器，性能较麒麟 990 提升 50%，将由华为 Mate 40 首发搭载。而麒麟 820 则将使用 7 纳米技术，集成 5G 基带，将首先应用于华为 nova 7 或荣耀 10X。（来源：[Sina](#)）

2019年12月6日

苹果预计将于 2020 年 3 月发布平价 iPhone 9

智能手机

苹果

苹果预计将于 2020 年 3 月发布新款 iPhone 9。新 iPhone 外观设计将与 iPhone 8 相似，配备 4.7 寸屏幕和 home 键，支持 Touch ID，但将搭载 A13 Bionic 芯片。起售价可能为 399 美元，预计 2020 年出货量将达到 3,000 万件。（来源：[MacRumors](#)）

2019年12月6日

三星即将发布可纵向折叠的手机 Galaxy Fold 2

智能手机

三星

三星已经确认在开发可在纵向上折叠的手机，与售价 1,500 美元的摩托罗拉 Razr 竞争。近期有媒体报导三星可折叠手机的售价可能远低于预期，售价将大约在 845 美元左右。三星 Galaxy Fold 2 据称将配备可支持 5 倍光学变焦的摄像头，将会于明年 2 月 Galaxy S11 发布时正式发布产品信息。同时，此台设备还或将支持 5G 及 25W 快速充电。（来源：[Tomsguide](#)）

2019年12月6日

高通发布 XR2 平台，支持 5G AR 和 VR 设备

半导体

高通

在高通举行的高通骁龙技术峰会上，高通正式发布了其骁龙 XR2 平台，该平台号称世界首个支持 5G 拓展现实的 XR 平台。XR2 的显示单元可支持高达 90fps 的 3Kx3K 单眼分辨率，也是首个在流传输和本地播放中支持 60fps 的 8K 360 度全景视频的 XR 平台。与高通公司当前的 XR 平台相比，Snapdragon XR2 平台在 CPU 和 GPU 性能、视频带宽、分辨率和 AI 方面均具有显著的性能改进。（来源：[Techcrunch](#)）

2019年12月5日

村田制作所开发出超小型多层陶瓷电容器

元件

村田制作所

村田制作所开发出超小型多层陶瓷电容器，型号为 GRM011R60J104M。相比同容量产品，这款新产品的表面积缩小了一半、体积减小至五分之一；储存容量则是同尺寸产品的十倍。随着 5G 的普及，电子元件需要小型化、高密度化，这款新产品满足这一要求，可以被应用于智能手机与可穿戴设备，将于 2020 年开始量产。（来源：[Murata](#)）

2019年12月4日

半导体

高通

高通发布骁龙 865 和骁龙 765 处理器，预计 2020 年第一季度开始发售

高通正式发布了新一代骁龙移动平台，包括骁龙 865、骁龙 765/骁龙 765G。

1) 骁龙 865: 骁龙 865 主要为旗舰级设备设计，使用了公司无线设备及处理器等方面最新的技术，继承了最新的 Kryo 585 CPU、Adreno 650 GPU 图形核心、第五代人工智能引擎，Spectra 480 CV-ISP 等诸多模块。

2) 骁龙 765/765G: 骁龙 765 和骁龙 765G 均使用高通公司的新一代 AI 引擎和低功耗传感集线器，使设备能够情境感知语音指令，且不消耗更多电量。集成的 ISP 还支持多摄像头拍摄，使用户可以同时从主摄像头、望远摄像头和广角摄像头进行拍摄。它还可拍摄 4K HDR 视频。骁龙 765/765G 使用新的 Kryo 475 CPU 内核，主频高达 2.3GHz。同时还搭载 Adreno 620 GPU，比上一代产品性能提高 20%。

骁龙 765 针对大部分主流手机设计，骁龙 765G 主要为游戏设计。骁龙 765 和骁龙 765G 之间的主要区别是 765G 相比 765 图形性能提高了大约 10%。（来源：[Anandtech](#)）

2019年12月3日

云计算

金山/小米

金山软件与小米签订三年框架协议

金山软件与小米签订三年框架协议。金山软件将向小米提供若干综合服务，包括云服务、推广服务、邮箱定制开发服务及广告代理服务；与小米共同经营金山开发的游戏；向小米提供包括独立第三方制造的服务器、存储设备、负载均衡器等硬件产品。小米也将向金山软件提供推广服务、软件开发服务、餐厅服务等，并向金山提供小米的产品。（来源：[Sina](#)）

2019年12月3日

智能手机

小米

小米 10 将会为首批搭载骁龙 865 处理器的智能手机

小米新一代旗舰机小米 10 将于 2020 年 2 月发布。小米 10 将会搭载 Snapdragon 865 八核处理器，同时搭载高通 X55 芯片，支持 5G。小米 10 将会采用 6.2 英寸 AMOLED 屏幕，配备 5000 毫安电池，并可支持 40W 快充。有媒体报导称该手机将会搭配三摄，分别为一个 4500 万像素摄像头，及两个 1200 万像素摄像头。小米 10 具体细节还需等待后期正式发布。（来源：[Notebookcheck](#)）

重要声明

分析师声明

我们，李小明、李蕾和吴若滢在此证明，（i）本市场评论中表述的任何观点均精确地反映了我们对有关市场、公司及其证券的个人看法；（ii）我们所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接与我们在本市场评论中所表达的具体建议或观点相联系，也不与尚乘环球市场有限公司的交易相联系。

在本市场评论发布当日，李小明拥有评论中提及到与 Amazon 有关的财务权益。

尚乘环球市场有限公司

地址：香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 23 楼 - 25 楼

电话：(852) 3163-3288 传真：(852) 3163-3289

一般性声明

市场评论由尚乘环球市场有限公司（“尚乘”）编制，仅供尚乘的客户参考使用，尚乘不会因接收人收到本市场评论而视其为客户。

本市场评论仅提供一般信息，并非作为或被视为出售或购买或认购证券的邀请。本评论内提到的证券可能在某些地区不能出售。本评论（i）不提供构成个人意见或建议，包括但不限于会计、法律或税务咨询或投资建议；或（ii）不考虑特定客户的特定需求，投资目标和财务状况。尚乘不作为顾问，也不会对任何财务或其他后果承担任何受托责任或义务。本市场评论不应被视为替代客户行使的判断。客户应考虑本市场评论中的任何信息，意见或建议是否适合其特定情况，并酌情寻求法律或专业意见。

本市场评论所载资料的来源被认为是可靠的，但尚乘不保证其完整性或准确性，除非有尚乘和/或其附属公司的任何披露。对于本市场评论提及的任何证券，其价值、价格及其回报可能波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。未来的收益不能保证，本金可能会损失。

市场评论所载的资料，估计，观点，预测和其他信息均反映发布评论当日的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改。尚乘及其附属公司或其任何董事或雇员（“尚乘集团”）并不明示或暗示地表示或保证市场评论中包含的信息正确、准确或完整。尚乘集团对使用或依据市场评论及内容不承担任何责任或义务。

本市场评论可能包含来自第三方的信息，例如信用评级机构的信用评级。除第三方事先书面同意，禁止以任何方式复制和再分发任何形式的第三方内容。第三方内容提供者不保证任何信息的及时性、完整性、准确性或可用性。第三方不对任何错误、遗漏或使用这些内容所获得的结果负责。第三方内容提供商不提供任何直接或间接的保证，包括但不限于任何用于特定用途适用性或适销性的保证。第三方内容提供商不对使用其内容造成的任何直接、间接、偶然、示范、补偿、惩罚、特殊或间接的损害、费用、开支、法律费用或损失（包括收入或利润损失和机会成本）负责。信用评级是意见声明，不是购买、持有或出售证券的行为或建议声明。第三方并没有强调所涉及的证券适用于投资目的，也不应该作为投资建议。

在有关的适用法律和/或法规允许的范围内：（i）尚乘和/或其董事和雇员，可以作为被代理人或代理人，对本评论所涉及的证券或其他相关金融工具，进行买卖、建仓或平仓（ii）尚乘可以参与或投资市场评论中提及的证券发行人融资交易，或提供其他服务或承销；（iii）尚乘可以对在 market 评论中提到的发行人提供做市；（iv）尚乘可能曾担任本评论提及证券公开发行的经办人或联合经办人，或者可能会在本评论中提及证券的发售过程中提供暂时做市，或可能在过去 12 个月内提供其他投资银行服务。

尚乘通过其合规政策和程序（如信息隔离墙和员工交易监控）来控制信息流和管理利益冲突。

本市场评论所载内容的版权为尚乘所有，未经尚乘环球市场有限公司事先书面授权，本市场评论的任何部分均不得以任何形式转载或以任何形式转载给任何人。
